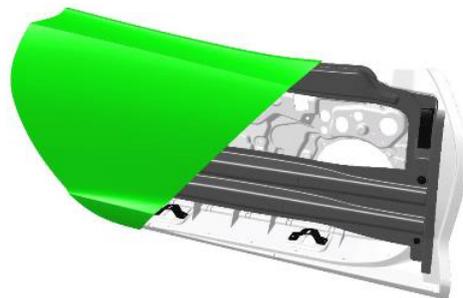


Modulo porta più leggero del 35%

Sarà esposto nei prossimi giorni da Teijin a Parigi in occasione del JEC World 2019. Potrebbe essere montato sui veicoli entro il 2025.

6 marzo 2019 08:35

Teijin Composites Innovation Center (TCIC) e Continental Structural Plastics (CSP), entrambi parte del gruppo giapponese Teijin, hanno sviluppato un modulo porta per autovetture in materiale composito estremamente leggero, che verrà presentato in anteprima alla prossima edizione di JEC World 2019, dal 12 al 14 marzo a Parigi.



Il modulo, infatti, pesa il 35% in meno rispetto ad uno tradizionale in acciaio grazie all'utilizzo di SMC (sheet molded compound) con fibra di carbonio e fibra di vetro, combinati con termoplastiche rinforzate con fibre unidirezionali, al fine di garantire, oltre all'alleggerimento, anche la necessaria resistenza meccanica e agli urti per superare i crash-test. Anche la resistenza termica sarebbe compatibile con i processi di verniciatura di tipo E-coat.